## 鉛フリー半田対応コンパクトサイズN2リフローシリーズ COMPACT N2 REFLOW SERIES FOR LEAD FREE SOLDER



## 主な特長

- 温度精度(面内温度分布)の向上と低酸素濃度下での 半田付けを目的にした電子デバイスメーカー向け リフロー装置!
- 2. クリーンルーム対応・コンパクト設計・省エネ化を追求!
- 3.小型ながら5ゾーンの加熱ゾーンを装備! 多彩な温度プロファイルを設定できます。
- **4.** BGAやCSPの半田ボール形成用リフローとしても ご使用できます。
- 5.ローダー/アンローダーや中間バッファーを含む 周辺装置も取り揃えております。
- 6. 温度プロファイルモニターや酸素濃度自動コント ロール、窒素発生器などのオプション群もさらに充実。

## **Major features**

- The reflow equipment for electronic device manufacturers featuring its improvement in temperature accuracy (in-plane temperature distribution) and for soldering in the atmosphere in low oxygen density!
- 2. Pursuiting its ideal application in clean rooms, compact design and energy-saving performance.
- Small in dimensions and yet equipped with heating zones as many as five zones. It allows you to set a variety of temperature profiles.
- 4. Designed for additional use for reflow for forming of soldering balls such as BGA, CSP and many others.
- 5. Available are a large assortment of peripheral equipment including loaders, unloaders and intermediate buffers.
- Optional equipment available from Yamato Works includes temperature profile monitors, automatic oxygen density controls, N2 generators and many others.

## YAMATO WORKS CO.,LTD.